

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司（以下简称“晶艺半导体”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司的全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条有关规定：

“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

在本次交易前 12 个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年8月6日